

HyperQube 6.00mm 大電圧、 高電流相互接続システム

HyperQube製品ファミリーは、モレックスのCouerソケットテクノロジーを使用した高電圧、高電流向けの革新的な高性能コネクタシステムです。Couerソケットテクノロジーによりコンタクトの接触面を大きくして発熱を最小限に抑制し、スペースに制約のあるアプリケーションの需要に応える大電流伝送能力を実現。HyperQube相互接続製品は厳しい各種業界規格を満たす、高機能、高効率な製品です。ハイパワーなHyperQubeコネクタ製品は確実な接続、搭載作業の簡素化、パフォーマンスの最適化に貢献します。

特徴&利点

コンパクト設計で省スペースを達成

嵌合高さ (19.50mm)、
嵌合長さ (43.70mm)、幅 (17.70mm)、
スペースに制約のあるアプリケーションに適する。

正確嵌合が容易、 作業時間の短縮に貢献

プラグハウジングと基板実装リセプタクルは3色を用意し、複数のケーブルアセンブリを使用しているアプリケーションでの搭載作業時にも色による識別が可能で、正確な嵌合作業を実現します。

高電力密度

定格電流120.0A、
プリント基板 (PCB) フットプリント
12.30 x 15.40mm、
PCB 1 cm² あたり電流密度は63.4A。

安定して電氣的性能を発揮

モレックスのCoeurソケットテクノロジーの特長である、接触面の接触抵抗の低さにより発熱を抑え、大電流の供給を実現しています。ビーム接点を複数設けた、高衝撃・高振動アプリケーションに理想的な構造です。

電流	120.0A
電圧	1000V
適合業界規格	UL 94V-0
使用温度範囲:	-40 ~ +125°C

基板 / バスバー上の正確位置に リセプタクルを正しい姿勢で実装し、 生産工程での問題を排除

基板用リセプタクルの色ごとに、
極性保護ペグの寸法および位置が異なる。
このメカニカルキー構造により、基板実装
リセプタクルに正確に位置を合わせた嵌合
が可能です。

設計柔軟性を提供

基板実装リセプタクルの嵌合部をネジ形状とし、基板とバスバーの両方への取り付けが可能。圧着コンタクトは複数 (2、4、6AWG) から選択可能で、各種アプリケーションの電力伝送要件に対応します。

組立時の柔軟性を提供

基板用リセプタクルの嵌合部はネジ形状となっており、作業時にコネクタを損傷した場合も基板 / バスバーへの付け直しが可能。

作業者の安全を確保

安全面の特長として、嵌合するHyperQubeコネクタのソケット、圧着コンタクト、およびケーブルアセンブリの裸線部分にカバーを装着して提供。コネクタ側に感電防止対策を施すことで、作業者を感電から保護します。



HyperQube 6.00mm 大電圧、 高電流相互接続システム

市場・アプリケーション

データセンター

サーバー
スイッチ

蓄電

インバーター

産業オートメーション

モーター



サーバー



インバーター



モーター

製品特徴・仕様

参考データ

梱包形態:

圧着端子: 袋

リセブタクルアセンブリー: トレイ

プラグハウジング: 袋

UL File No.: 申請中

CSA File No.: 申請中

適合製品: PCB、バスバー

寸法単位: mm

RoHS: 準拠

機械的性能

嵌合力: 35N

抜去力: 4N

耐久挿抜回数: 200回

電気的性能

最大定格電圧: 1,000V

最大定格電流: 120.0A

接触抵抗: 0.20 mΩ以下

物理的性能

プラグハウジング: PBT、ローハロゲン

圧着端子: 銅 (Cu) 合金

リセブタクルハウジング: PBT、ローハロゲン

リセブタクル各部: アルミ合金 / ステンレス鋼

めっき:

ソケット—金 (Au)

ピン—銀 (Ag)

基板厚 (最大): 2.00mm

バスバー厚 (最大): 2.00mm

RoHS準拠

REACH規則適合

難燃性: UL 94V-0

使用温度範囲: -40 ~ +125°C

www.molex.com